

G-ALCS Technology

(Glass All Layer Z-Connection Structure)

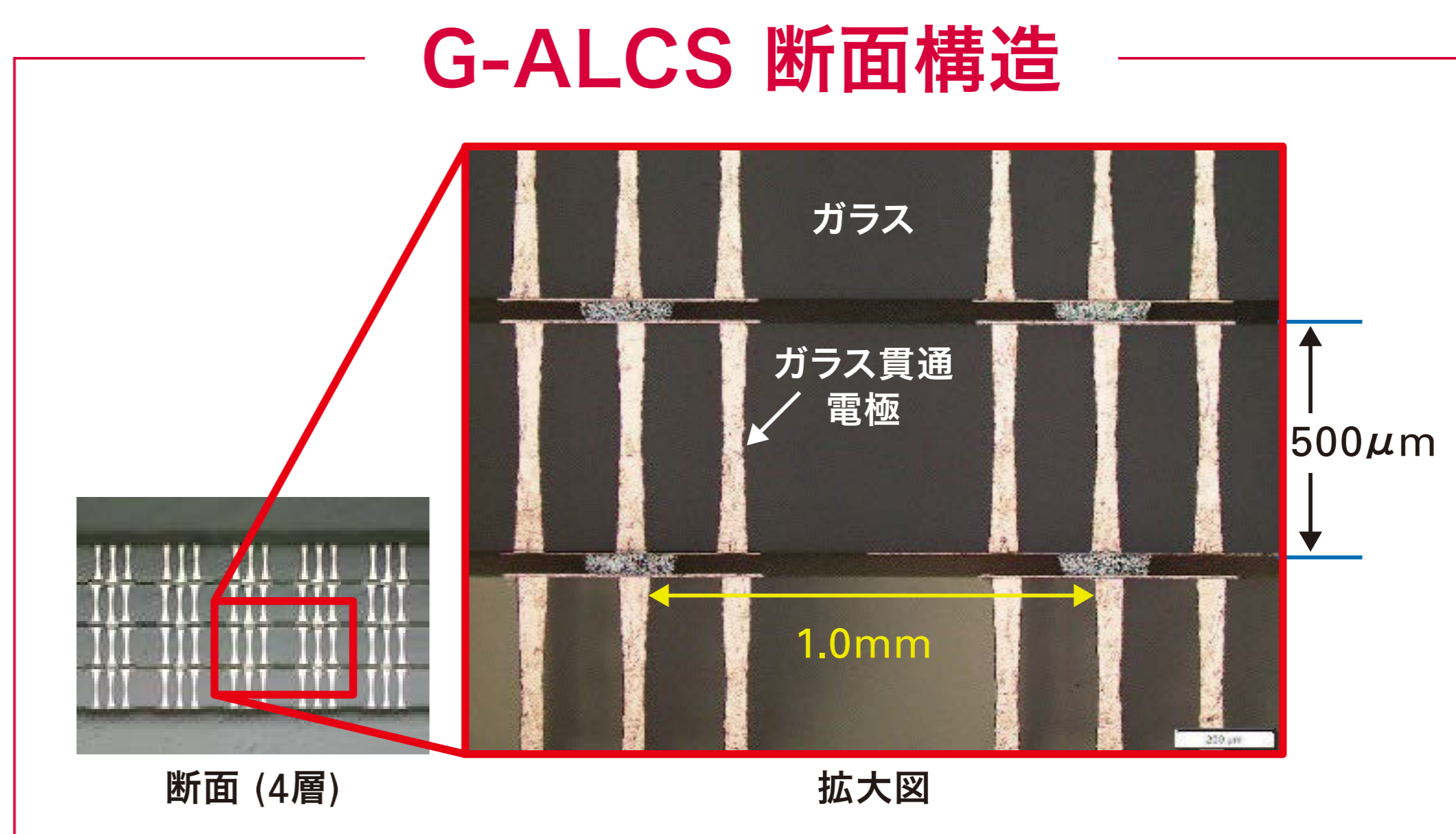
先端実装パッケージに対応するガラス多層配線板

高温環境下で高い寸法安定性を実現する「G-ALCS」技術

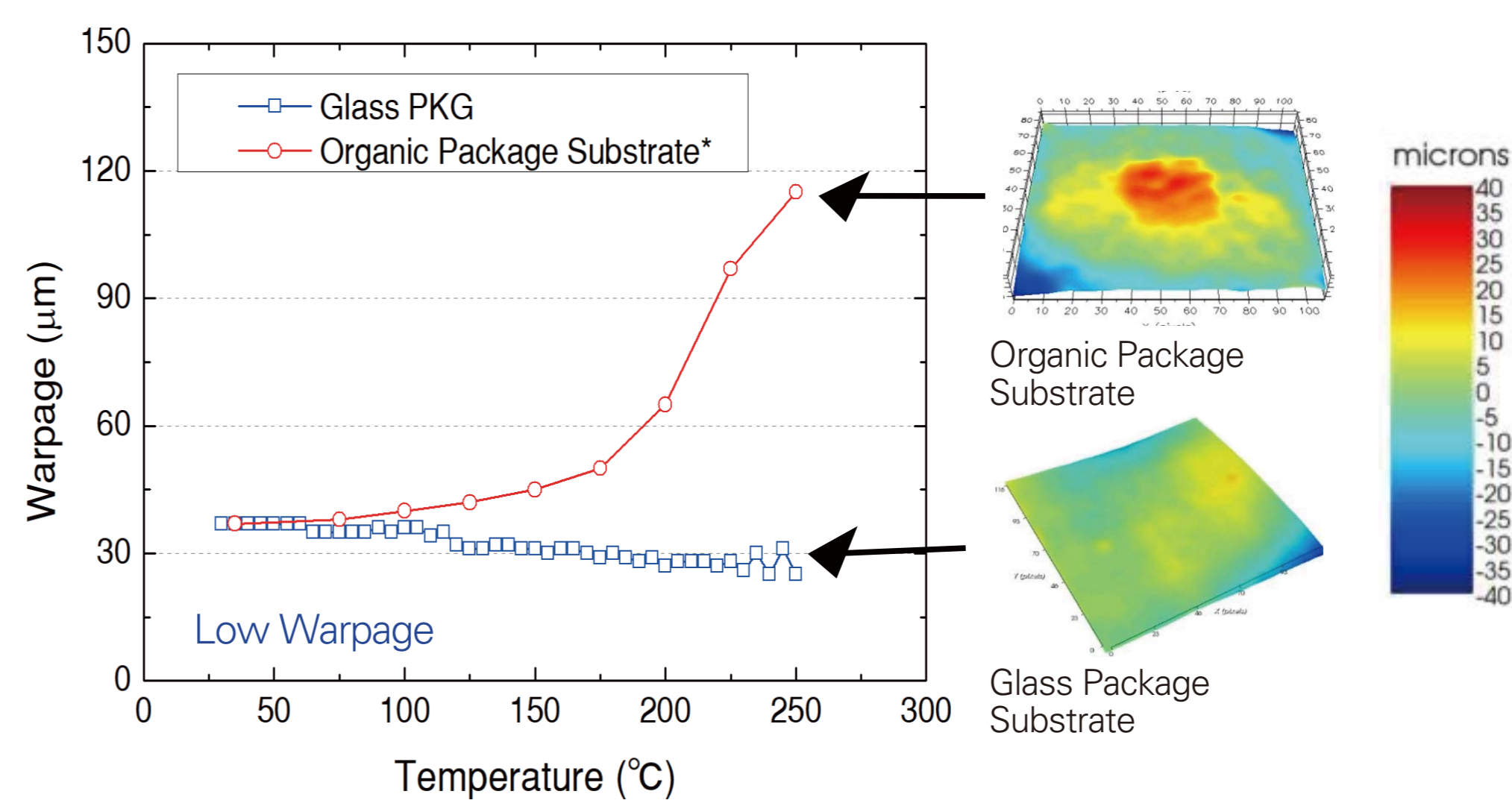
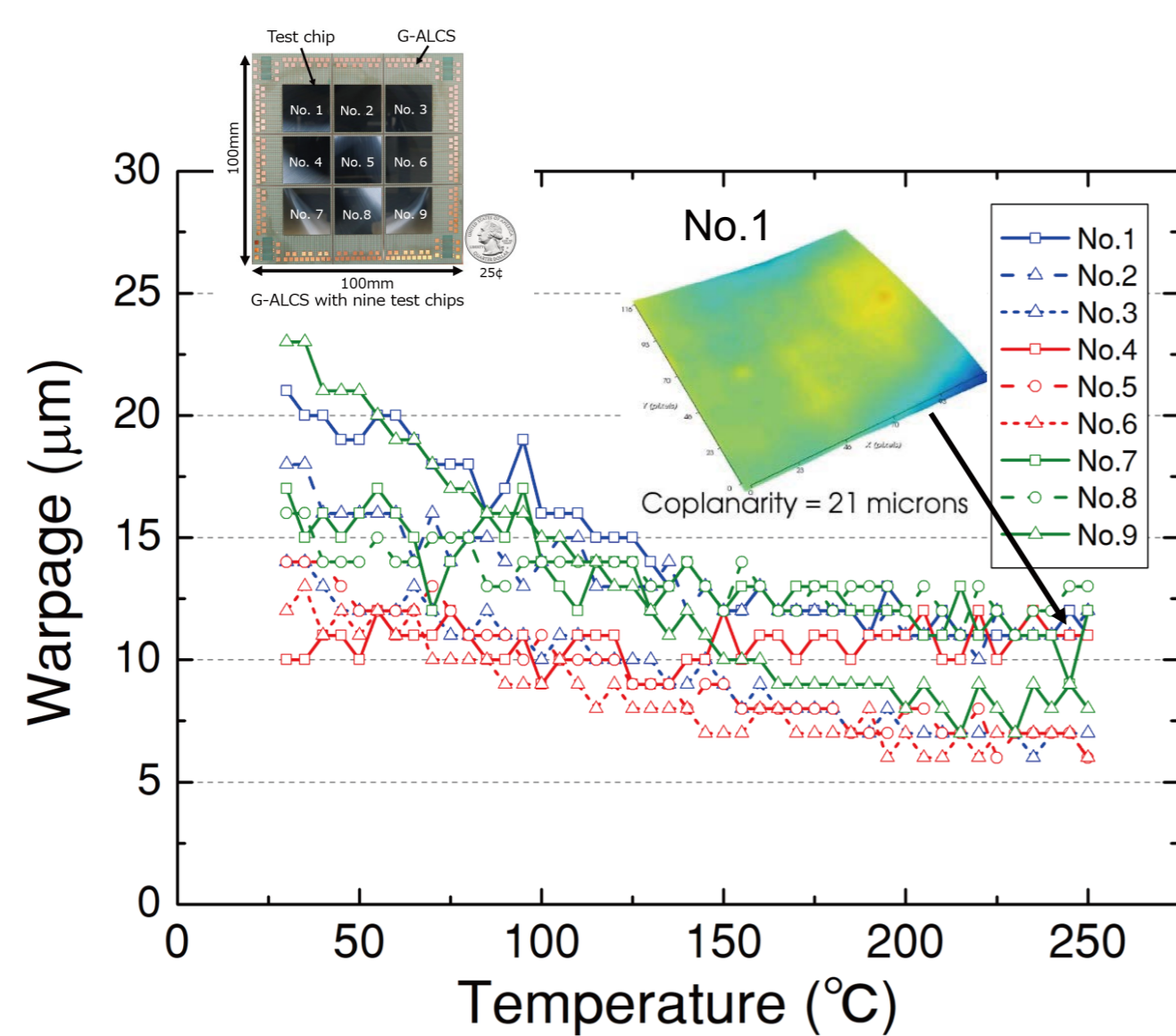
チップレット実装や精密な光学部品の実装に有利

■ ガラス多層配線板の特徴

- ▶ 高い配線密度
- ▶ 高耐熱性
- ▶ 高い平坦性
- ▶ 低伝送損失

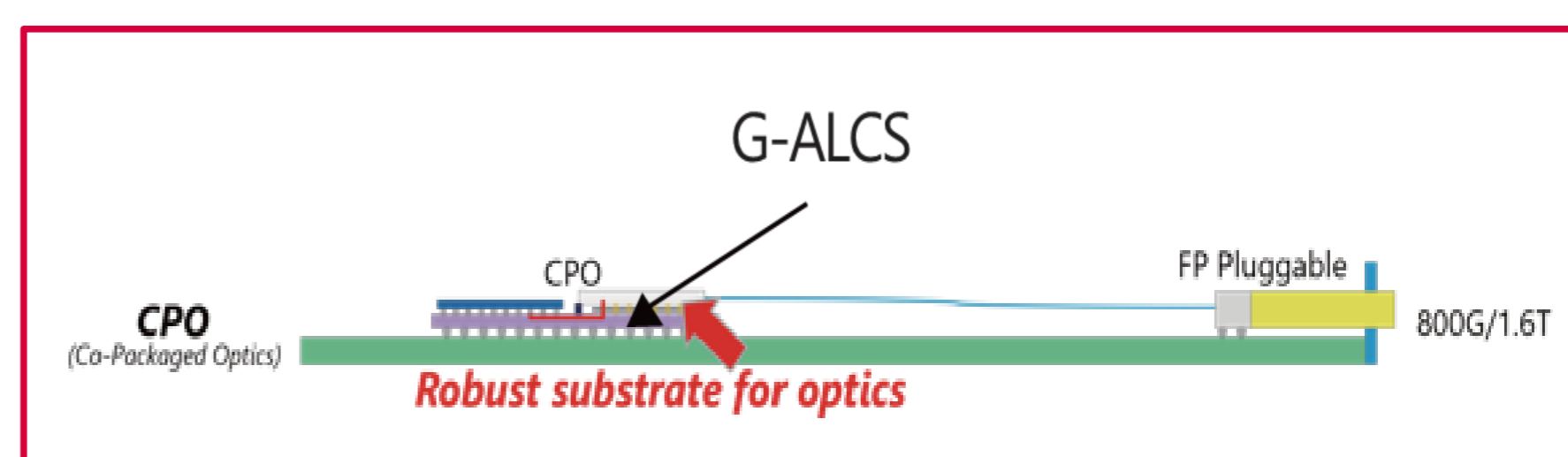
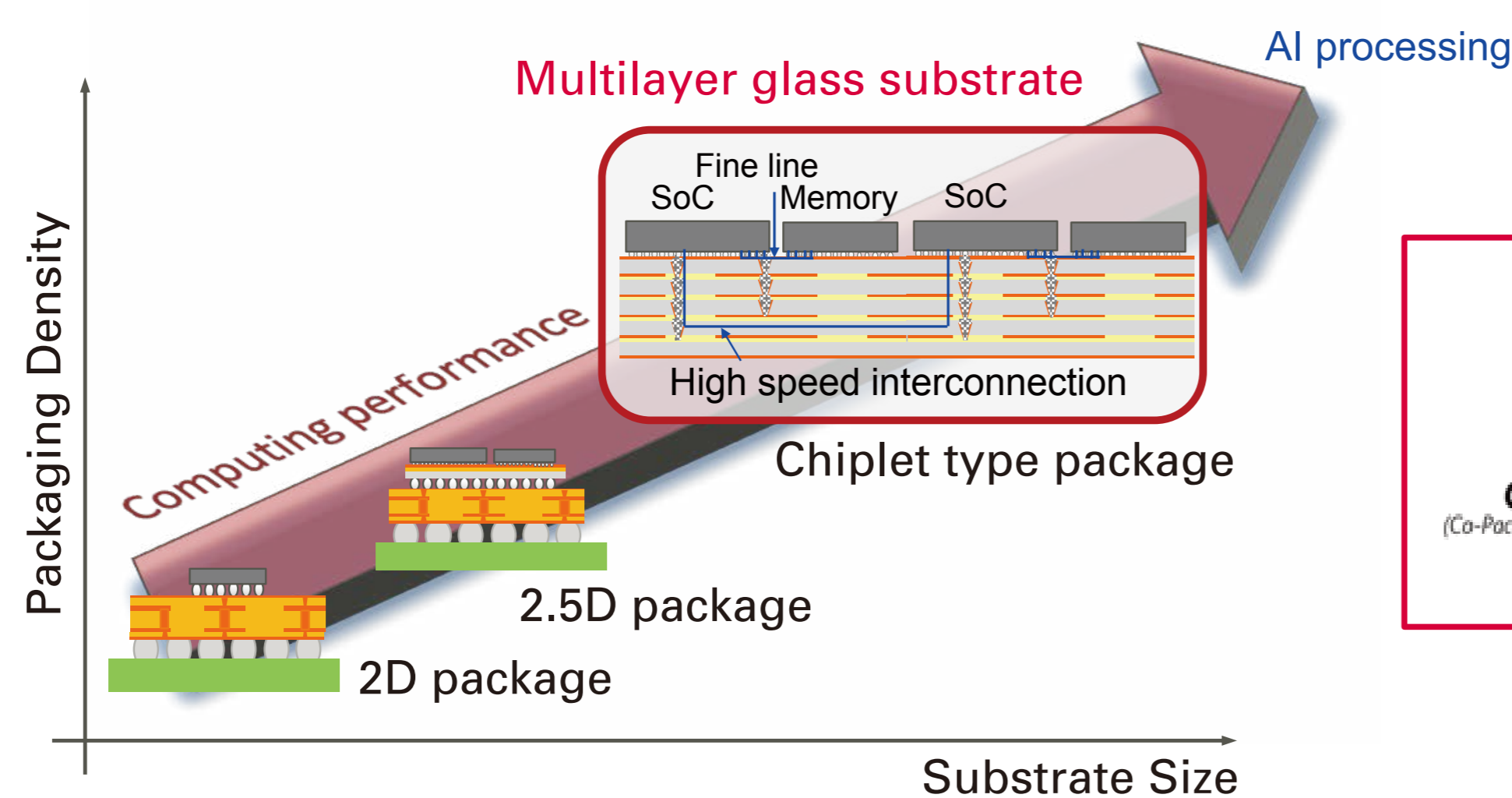


■ G-ALCSの特徴



ファインピッチ実装における高い平坦性

The Proposal for Chiplet/Co-Package Optics Applications



An Optical Packaging Image for High-speed transmission

